

中电广通股份有限公司
关于回复上海证券交易所对公司2015年年度报告
事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年3月3日收到《关于对中电广通股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函〔2016〕0206），根据《问询函》要求，现对相关问题回复如下：

一、关于行业竞争格局及公司市场定位

集成电路（IC）卡及封装行业竞争激烈，产品更新迭代迅速，细分领域众多，作为充分竞争及技术密集型行业，行业呈现少数龙头和多、散、小企业并存的格局。公司未能根据《格式准则第2号》第二十八条的规定，充分披露有关行业竞争格局以及公司市场地位等方面的重大信息。

1. 年报披露，公司IC卡应用范围较广，领域包含身份识别、金融支付、移动通信、交通、城市公共服务等。请公司结合自身的业务

规模、行业细分领域、产品竞争力、市场需求及产能、产品技术壁垒以及竞争对手等情况，详细分析公司在 IC 卡及封装服务方面经营模式、业务现状及发展前景，核心竞争力和主要的业绩驱动因素，以及公司的竞争优劣势。此外，请按照 IC 卡的使用范围，披露公司在相关领域的市场地位、市场份额及行业排名等信息。

回复：

中电广通股份有限公司（以下简称：中电广通、公司）控股子公司中电智能卡有限责任公司（以下简称：中电智能卡）是一家以集成电路（IC）卡及模块封装为主的生产型企业，为行业内集成电路芯片设计企业和应用开发商服务，按照客户需求进行相关产品的生产加工。

1、公司产品主要应用领域

产品	应用领域
非接触模块	身份识别（身份证、门禁卡、会员卡、交通卡）
双界面模块	金融支付（银行卡、社保卡、公交卡）
SIM 卡及 SIM 卡模块	移动通信（手机卡）
加油卡	中石化、中石油加油卡
社保卡模块	城市公共服务（社保卡）

2、主要集成电路（IC）卡及模块产品销量及销售收入

应用领域	销售数量 单位（万片）	销售收入 单位（万元）
身份识别	5,116	4,166
金融支付	2,595	830
移动通信	42,193	11,931
交通	5,258	2,126
城市公共服务	4,789	1,358

3、公司始终注重核心竞争力的培养，持续不断地创新技术、控制成本、保证质量，其主要竞争优势为：研发能力强，研发出多项具有自主知识产权的先进封装技术和关键设备；高效生产和规模效应；多年积累的专业化人才队伍；通过 EAL5+国际安全标准认证的生产环境。公司主要业绩驱动因素为技术创新和产品质量。但是，公司也面临智能卡所处行业增长规模有限的不利因素。

4、竞争对手及竞争格局

(1) 在非接触模块和双界面模块封装方面，主要竞争对手为：大唐微电子、上海伊诺尔、山东齐芯等，公司在该领域具有很强的竞争优势，市场份额排名第一；

(2) SIM 卡和加油卡封装方面，主要竞争对手为：深圳毅能达、北京意成等；公司在该领域具有很强的竞争优势。

5、由于中电智能卡领先的工艺技术和优良的产品质量，能够为客户提供竞争对手无法替代的先进技术，如具有自主知识产权的身份证模块专用大批量生产技术、六小卡封装技术和 CSP 模块封装工艺技术等，满足客户的特殊需求，具有较强的竞争优势，获得了客户的信任，在国内主要 IC 卡应用领域占有较大市场份额。中电智能卡连续 8 年获得国家金卡工程金蚂蚁奖（创新奖和最佳配套奖），多次获得国家科委、北京市、半导体行业协会等授予的科技创新奖。

按照 IC 卡的使用范围，公司主要产品的市场份额如下：

使用范围	市场份额
非接触模块（身份证、交通卡）	第一
双界面模块（国产金融卡、交通卡）	第一
社保模块	30%左右
SIM 卡模块	15%左右
SIM 卡	40%左右
加油卡	70%左右

说明：以上数据来源于中国信息产业商会智能卡专业委员会、公司主要客户。

服务随着金融 IC 卡大批量推广和移动互联的快速发展，市场需求稳定增长，业务前景良好。

2. 电子行业产业链较长，主要分为“芯片设计-芯片制造-封装测试-装备与材料”，公司处于产业链的中游，且关联交易较多。报告期公司存在大额的关联采购及销售，其中采购金额合计 2124 万元，销售金额为 1.57 亿元。请公司结合产业链的上下游关系，以及在中国电子信息产业集团有限公司中的定位和具体业务种类，详细分析公司关联采购及销售的金额及占比情况，进行关联交易的必要性和合理性，以及关联交易定价的依据及其公允性。

回复：

2015 年关联方采购、销售金额及占比情况：

单位：元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务					
北京中电华大电子设计有限责任公司	采购商品	购买原材料	市场价格	216,974.06	0.14
上海华虹集成电路有限责任公司	采购商品	购买原材料	市场价格	18,627,742.40	12.31
中国电子器材总公司	采购商品	购买商品	市场价格	488,452.67	0.28
北京银证信通智能卡有限公司	采购商品	购买原材料	市场价格	1,910,317.86	1.26
小计				21,243,486.99	13.99
销售商品、提供劳务					
北京华虹集成电路设计有限责任公司	销售商品	销售货物	市场价格	4,911,670.78	2.29
北京华大智宝电子系统有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	14,333,108.70	6.69
北京中电华大电子设计有限责任公司	销售商品	销售货物	市场价格	65,688,346.31	30.67
上海华虹集成电路有限责任公司	销售商品	销售货物	市场价格	49,247,787.27	22.99
北京银证信通智能卡有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	21,195,714.55	9.90
南京熊猫信息产业有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	1,000,000.00	0.52
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	278,395.64	0.14
中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	销售货物	市场价格	199,420.00	0.10
小计				156,854,443.25	73.30

关联方采购商品合计 2,124.35 万元，其中与中电智能卡业务相关的金额为 2,075.50 万元，占比 97.70%；其他业务 48.85 万元，占

比 2.30%。关联方销售金额合计 15,685.44 万元，其中与中电智能卡业务相关的金额为 15,537.66 万元，占比 99.06%；其他业务 147.78 万元，占比 0.94%。关联方采购、销售金额中绝大部分为子公司中电智能卡发生的关联交易。

上海华虹集成电路有限责任公司、北京中电华大电子设计有限责任公司为中电智能卡业务的主要关联方，公司与其业务往来模式为两类：第一类是上海华虹和华大电子将 IC 卡芯片（wafer）交给公司，公司按要求加工成 IC 卡模块，按指定方式交货并收取加工费；第二类是公司从上海华虹和华大电子采购 IC 卡芯片（wafer），公司按客户要求加工成模块或卡片，销售给第三方客户。

中电智能卡主营业务为集成电路（IC）卡及模块封装，在智能卡产业中处于中间地位。中国电子信息产业集团有限公司下属的北京华大电子集成电路设计公司和上海华虹集成电路设计公司主营业务为智能卡芯片设计和销售，是中电智能卡的模块封装业务主要客户；中国电子所属的北京华虹集成电路设计有限责任公司、北京华大智宝电子系统有限公司和北京银证信通智能卡有限公司为智能卡应用开发商，是中电智能卡的卡片封装业务主要客户。由于中电智能卡领先的工艺技术和优良的产品质量，能够为客户提供竞争对手无法替代的先进技术，如具有自主知识产权的身份证模块专用大批量生产技术、六小卡封装技术和 CSP 模块封装工艺技术等，满足客户的特殊需求，获得了以上客户的信任。中电智能卡连续 8 年获得国家金卡工程金蚂蚁

奖（创新奖和最佳配套奖），多次获得国家科委、北京市、半导体行业协会等授予的科技创新奖。

以上几家企业为行业内领先的芯片和应用开发商，与中电智能卡的关联交易完全按照市场竞争原则，按市场价格执行；其他关联交易也是完全按照市场竞争原则，按市场价格执行。即使公司不与上述关联方发生关联交易，公司仍然可以持续经营，由于公司独有的非接触式模块大批量生产技术，被政府相关部门指定为身份证模块特许生产企业。

3. 公司近年来 IC 卡及封装业务收入稳定在 2 亿元以上，毛利率在 30%上下波动。请公司结合集成电路（IC）卡及模块封装行业其他上市公司的毛利率情况、公司的技术水平和特点以及关联交易情况，对比分析公司毛利率水平大幅高于行业平均水平的原因，并重点分析影响公司毛利率波动的主要因素。

回复：

公司主营业务为集成电路（IC）卡及模块加工，模块加工的主要产品为接触式模块、非接触模块和双界面模块，并在行业内占据较大的份额（特别是身份证专用模块、加油卡等），相对于竞争对手，公司具有多样化的工艺技术和更完善的生产加工服务链，如公司独有的身份证模块专用生产技术、加油卡模块专用黑胶封装工艺技术，以上领先的工艺技术和规模效应，以及精确的流程控制，导致比竞争对手具有更低的材料成本和更高的生产效率，综合成本远低于同行业平均

水平，取得了高于行业平均水平的利润率。

在卡片加工业务方面，卡片加工的主要产品为电信 SIM 卡、加油卡、社保卡等，公司自主研发出国际上唯一的先进的多小卡封装技术，取得了相应的发明专利，在满足客户要求的同时，大幅提高了生产效率、降低了生产成本，如 SIM 卡产品降低直接材料成本 80%以上，取得了较高的利润率。

公司集成电路（IC）卡及模块封装业务与其他上市公司经营模式不同，因此在毛利率方面不具有可比性。该业务短期内不会有爆发式增长。

影响公司毛利率波动的主要因素包括市场竞争价格、人力成本、材料成本、工艺技术、精益管理、汇率波动、竞争对手的技术更新等。其中，核心因素为公司自主研发的独有工艺技术和精益管理，如自主研发的非接触式模块大批量生产技术导致公司被政府相关部门指定为身份证模块专用生产企业，从而获得了利润率较高且稳定的身份证模块生产订单；同时，公司高水平的精益化管理确保了大批量生产的产品质量和安全交货，从而获得长期稳定的订单。

二、关于销售模式及财务数据异常

公司所处的集成电路（IC）卡及封装、IBM 服务器的集成与分销行业并无明显的季节性特点，但公司收入的季度分布前大后小，波动幅度异常。此外，报告期内存在收入大额调整等情况，公司未能充分、合理解释原因。

4. 请结合公司的经营模式和业务特点，说明公司各类业务的销售模式及其具体的收入确认方法。

回复：

一、集成电路（IC）卡及模块封装业务主要经营模式为委托加工直销，由客户提供相关材料，中电智能卡按照客户要求要求进行加工，先与客户签订合作协议，再按客户具体要求进行加工生产，并按照协议约定的价格和付款方式付款。

二、计算机系统集成与分销业务经营模式为代理分销和技术服务，主要代理产品为 IBM 服务器及软件，主要客户为电信、银行、铁路等行业性客户。前几年，由于 IBM 服务器技术领先，在市场具有绝对优势，根据 IBM 公司要求，代理分销商需提前备货。

三、收入确认方法

1、公司集成电路（IC）卡及模块封装收入确认方法为：

（1）自主采购原材料并生产销售模式的收入确认依据：将产品实际运到客户指定地点后，经客户确认验收后确认收入。

（2）来料加工模式的收入确认依据：产品加工完成后，将产品运到客户指定地点，经客户确认无误后按照提供的加工费确认收入。

2、计算机系统集成与分销收入确认方法为：

对于只供货客户，公司将货物发出，购货方签收无误后，发货签收单返回公司，商务部门核对无误后确认收入。对于供货并提供解决方案客户，以发货签收单和服务报告单或验收报告，确认收入。

5. 请公司结合行业周期、公司历史业务波动、业务类别及其收入确认、在手合同及订单等方面，分析公司收入逐季下降，从 2015 年第一季度的 1.41 亿元收入下降为第四季度仅 1112 万元的原因，并对公司的持续经营能力进行具体分析。请会计师发表意见。

回复：

一、行业周期及历史业务波动

集成电路（IC）卡及模块封装业务并无明显的规律性行业周期，公司在该业务运营方面一直保持相对稳健，营业收入和盈利水平也相对平稳。2015 年，集成电路（IC）卡及模块封装业务受市场需求波动、电信卡实名制及清库存影响，再加上市场价格竞争激烈，加工价格逐季下调，营业收入也出现下降。

计算机系统集成与分销业务，受服务器产品更新换代、信息安全自主可控政策影响，市场需求大幅萎缩，导致近几年收入持续大幅下降。

二、业务类别及收入确认情况

公司业务类别主要分为集成电路（IC）卡及模块封装和计算机系统集成与分销两类。

收入确认方法同“问题 4 回复”。

三、公司集成电路（IC）卡及模块封装业务订单情况

2016 年 1-3 月，集成电路（IC）卡及模块封装业务销售订单金额 7548 万元。

四、2015 年各季度收入情况及第四季度收入下降的原因

公司 2015 年度收入主要由集成电路（IC）卡及模块封装业务收入和计算机系统集成与分销业务收入组成，其年度内各季度确认收入情况如下表：

(1) 2015 年度集成电路（IC）卡及模块封装业务收入

单位：万元

2015 年	企业季度报表确认收入	企业年报调整收入金额	企业年报调整后确认收入
第一季度	10,731.63	-4,329.07	6,402.56
第二季度	7,311.10	-2,436.46	4,874.64
第三季度	7,935.89	-4,069.38	3,866.51
第四季度	6,276.63		6,276.63
合计	32,255.25	-10,834.91	21,420.34

注：公司集成电路（IC）卡及模块封装业务收入系子公司智能卡公司业务收入，公司在第四季度对委托加工收入按照净额法对前三季度进行了调整，公司第四季度无需调整事项。

(2) 2015 年计算机系统集成与分销业务收入

单位：万元

2015 年	企业季度报表确认收入	年度调整收入金额	企业年报调整后确认收入
第一季度	7,711.74		7,711.74
第二季度	11,184.42		11,184.42
第三季度	5,764.05		5,764.05
第四季度	6,820.38	-11,984.59	-5,164.21
合计	31,480.59	-11,984.59	19,496.00

注：公司计算机系统集成与分销业务收入系子公司北京中电广通科技有限公司（以下简称：科技公司）业务收入，公司在一至三季度对签订合同未交付实物的业务开具发票并确认营业收入 11,984.59 万元，同时确认营业成本 11,984.59 万元。公司在第四季度发现该业务不符合收入确认原则的情形，并对该类相关业务收入进行了调减，调减金额为 11,984.59 万元，同时调减相应成本金额。2014 年度不存在类似事项。

(3) 公司 2015 年度业务收入情况

单位：万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
集成电路（IC）卡及模块封装业务收入	6,402.56	4,874.64	3,866.51	6,276.63	21,420.34
计算机系统集成与分销业务收入	7,711.74	11,184.42	5,764.05	-5,164.21	19,496.00
合计	14,114.30	16,059.06	9,630.56	1,112.42	40,916.34

注：从上表可见，因子公司科技公司对应调减业务收入金额在第四季度进行了集中调整，造成第四季度计算机系统集成与分销收入为-5,164.21 万元，收入合计为 1,112.42 万元。但对该调减事项分别调减其应归属于各个季度的金额后，公司 2015 年度各个季度的收入情况如下：

单位：万元

2015 年	调整前各季度收入金额	智能卡调整收入金额	科技公司调整收入金额	调整后各季度收入金额
第一季度	18,443.36	-4,329.07	-2,003.49	12,110.81
第二季度	18,495.53	-2,436.46	-5,677.03	10,382.03
第三季度	13,699.94	-4,069.38	-3,657.09	5,973.47
第四季度	13,097.01		-646.98	12,450.03
合计	63,735.84	-10,834.91	-11,984.59	40,916.34

上表数据中“调整后各季度收入金额”为 2015 年营业收入最终数据，由于上述期间会计差错，公司将据此相应调整 2015 年度已经披露的季度报告、半年度报告及年度报告。

综合以上公司各类业务各季度收入构成情况可以看出，集成电路（IC）卡及模块封装业务收入中委托加工类项目收入按照净额法对各个季度进行了分别调整，不影响第四季度的收入确认金额。计算机系统集成与分销业务收入部分，对于签订合同开具销售发票未交付实物的销售金额 11,984.59 万元集中在第四季度调减收入，造成第四季度收入金额为 1,112 万元，通过对公司计算机系统集成与分销收入在各

个季度进行分别调整，公司第四季度的营业收入金额应为 12,450.03 万元。

五、公司的持续经营能力分析

(1) 目前，公司本部主要收益来源于对中国电子财务有限责任公司（以下简称：中电财务）和中电智能卡的投资收益，其中，中电财务近年的投资收益情况如下表：

单位：万元

年度	2013 年度		2014 年度		2015 年度	
	权益法确认的投资收益	其中：当年收到的分红	权益法确认的投资收益	其中：当年收到的分红	权益法确认的投资收益	其中：当年收到的分红
金额	3,660.49	2,377.80	3,545.37	2,377.80	4,728.09	2,377.80

公司通过中电财务实现的投资收益及收到的现金股利历年比较稳定，预计中电财务的经营状况未来不会产生重大波动。

(2) 公司集成电路（IC）卡及模块封装业务具有较强的市场竞争能力，2016 年预计市场需求稳中有升，公司可以保持稳定持续的经营能力。

中电智能卡近三年主要财务指标情况如下表：

单位：万元

项目	2013 年末（年度）	2014 年末（年度）	2015 年末（年度）
销售收入	25,017.50	22,964.23	21,420.33
净利润	2,277.27	3,523.02	2,785.65

(3) 由于 IBM 服务器代理业务大幅萎缩，公司计算机系统集成与分销业务持续亏损，公司决定停止该业务，已于 2016 年 2 月 5 日出售经营该业务的北京中电广通科技有限公司股权。

会计师意见：

通过对报告期内公司集成电路（IC）卡及模块封装业务收入和计算机系统集成与分销业务收入的检查和分析，并综合以上公司各类业务各季度收入构成情况可以看出，在计算机系统集成与分销业务收入部分存在 11,984.59 万元不符合收入确认原则，集中在第四季度调减收入，造成第四季度收入大幅度下降为 1,112 万元，考虑到调减收入金额对报告期内前三个季度的影响，并对报告内各个季度剔除调减项目后的收入金额进行还原，不存在第四季度业务收入严重下滑的情形。公司在前三季度对该部分业务确认收入未能严格执行公司该类业务收入确认原则，存在收入确认内部控制不规范情形，鉴于公司在第四季度进行了整改并调整，期末影响会计报表项目的相关内部控制制度整体有效并得到执行。

通过对公司各个业务板块近年的经营状况的分析，以及公司各个经营主体未来可预测年度内的业务预测和分析，我们认为，不存在影响公司持续经营能力的重大疑虑事项。

6. 公司 2015 年前三季度收入数据与前期季度报告披露的收入不一致，年报披露的原因为年末会计师事务所认为应采用净额法确认收入，因此进行调整。请公司从具体的收入核算原则、公司销售模式、合同条款等方面，分析公司对年度内收入进行调整的理由，以及公司以前年度财务报表是否存在同类会计差错需追溯调整的情形。请会计师发表意见。

回复：

公司子公司中电智能卡 2014 年开始与上海华虹集成电路有限责任公司签订了购买其芯片及相关软件产品并对委托其进行封装的采购合同/委托加工合同，公司对其产品进行封装后再销售给上海华虹集成电路有限公司，该部分收入属于公司集成电路（IC）卡及模块封装业务中的模块封装业务收入，该部分业务采用来料加工的销售模式，公司在 2015 年度一至三季度对该类型业务按照采购合同和销售合同视为两项独立的业务，分别记录采购和销售，按照其销售合同全额确认收入。

通过对中电智能卡与上海华虹签订的采购合同及销售合同/委托加工合同进行核查，并对其封装业务进行了解，尽管双方分别签订购销合同，但上述交易实质为来料加工收取委托加工费，应按照企业会计准则“实质重于形式”的委托加工业务收入确认原则，按照提供加工劳务，以净额法（即加工费）确认收入。

因此对于报告期内，对该类业务按照《企业会计准则-收入具体准则》委托加工业务，不应作为销售产品处理，应该按照净额确认收入，2015 年同时调减收入及成本 1.08 亿元，并对 2015 年度前三季度分别进行了调整。按照同样的原则，2014 年同时调减收入及成本 8,766.64 万元，该调整事项已在 2014 年年度报告进行了调整。

中电智能卡与上海华虹集成电路有限责任公司的上述委托加工业务始于 2014 年，以前年度没有此类业务发生，公司在 2014 年、2015 年对该业务按委托加工进行了调整，2014 年同时调减收入及成本

8,766.64 万元；2015 年同时调减收入及成本 1.08 亿元。

会计师意见：

1、子公司中电智能卡对于来料加工业务按照全额法确认收入，属于收入确认方法错误。该类业务按照企业准则及公司制定的具体业务收入确认原则，应按照来料加工收取加工费金额按照净额法确认收入。公司对该项会计差错进行更正并相应调整报告期内相应季度数据，属于当期发生会计差错并在当期调整事项，不存在追溯调整事项。

2、子公司科技公司 2015 年度将签订合同并开具销售发票但未交付实物的业务确认为营业收入，属于收入确认原则错误。该类未交付实物的业务不满足收入确认原则，按照企业会计准则不能确认收入。公司对该类会计差错在第四季度进行集中调整，属于当期发生的会计差错并在报告期内进行调整的调整事项，不存在前期会计差错并需追溯调整事项。2014 年度不存在类似事项。

7. 公司四季度收入仅有 1112 万元，年末发出商品金额为 2246.48 万元，计提跌价准备 770.61 万元，发出商品金额远大于第四季度收入。请公司结合销售模式及其确认方法，说明公司发出商品余额较大的原因，收入是否存在延迟确认的情况，以及发出商品阶段即计提减值准备的原因。请会计师发表意见。

回复：

通过上述“问题 5”中第四季度收入金额的分析结论可知，公司第四季度的营业收入金额应为 12,450 万元。期末发出商品 2246.48

万元，其中：1,475.87 万元为根据销售合同货物已经发出，按照销售商品确认原则，该类商品由于未收到客户的签收单、验收单，不符合收入确认原则，未确认收入，列入发出商品进行核算并披露。

发出商品中有 770.61 万元为公司业务开展初期借给客户试用的产品，公司在将该部分产品发出后，因该部分产品所有权未发生转移，产权归属公司所有，公司将该部分产品列入存货-发出商品进行核算。因产品技术更新换代，参考同类库存商品价值可变现价值，从 2013 年开始陆续计提了减值准备，2013 年计提了 112 万元，2014 年计提了 162.95 万元，2015 年计提了 495.66 万元，至 2015 年已经全额计提该类发出商品的跌价准备。

会计师意见：

通过对公司期末发出商品的发出时间及验收时间进行检查，会计师认为，该批商品在报告基准日尚未经客户签收并验收，不符合公司销售商品收入确认原则和具体确认条件。不存在延迟确认收入的情形。同时，对于期末发出商品中借出存货对应的可变现价格与其成本进行对比，同时参考本期评估机构的评估结果，按照成本与可变现净值孰低的原则计提相应的存货跌价准备。

三、关于公司发展战略及业务转型

公司主营集成电路（IC）卡及封装、IBM 服务器的集成与分销业务。随着国内对信息安全日益重视，核心软硬件国产化进程推进加速，公司 IBM 服务器集成与分销业务逐年大幅下滑。公司未能根据《格式

准则第 2 号》第二十八条的有关规定充分披露有关公司经营战略方面的信息。

8. 请公司结合行业壁垒、核心技术替代或扩散、产业链整合、价格竞争、成本波动等方面，充分披露公司的发展战略、未来发展机遇和挑战，以及相关的业务规划。

回复：

在集成电路（IC）卡及模块封装业务方面，公司将继续坚持科技创新和精益生产，巩固已有的领先优势，开拓国内外增量市场。充分发挥已有的竞争优势，抓住金融卡和电子证件大批量推广国产芯片、移动支付、物联网等新的市场机会，扩大具有领先优势的 CSP 生产技术和芯片减划产能，做大做强智能卡业务。

公司在集成电路（IC）卡及模块封装业务面临的挑战：新技术对传统智能卡市场的冲击，产业链整合导致竞争更加激烈。

为了加快转型升级，公司正积极推进清理低效无效资产，聚焦资源，并将利用公司多年积累的客户关系和人才资源，在集成电路和互联网综合数据服务领域寻找有利于公司发展的市场机会。通过内涵式发展和外延式并购，推动公司业务转型升级。

风险提示：公司正在互联网综合数据服务领域积极寻找新的发展机会，目前，并无实质性进展，敬请投资者注意投资风险。

9. 年报披露，我国集成电路发展稳步前进，成立了以国家为代表的产业基金，公司将利用计算机系统分销业务积累的客户资源优

势，加快转型升级，开拓新的业务。请公司说明加快转型升级及拟开拓新业务的具体规划和内容，并结合集成电路的发展及具体的外部环境变化，分析公司在封装业务核心技术的可复制性，产品多样化的可行性，以及面对的风险和挑战。

回复：

公司利用在集成电路（IC）卡及模块封装业务积累的竞争优势，抓住我国信息安全产品自主可控政策带来的集成电路发展的市场机会，向产业上下游延伸发展，在全产业链中寻找机会，快速提升芯片减薄划片技术，扩大 CSP 技术和芯片减薄划片产能。

公司的核心优势为较强的技术创新能力、控股股东的央企资源、良好的市场信誉和客户关系，以上优势使公司能够在 CSP 技术和芯片减划等新的领域实施业务拓展，具有较好的可行性。核心技术本身不可复制，但公司具有的核心优势可以在其他领域复制。公司正在探索向产业上下游延伸，目前尚无实质性进展。

公司在积极推进清理低效无效资产的同时，在互联网综合数据服务领域积极寻找新的市场机会，通过内涵式发展和外延式并购，推动公司业务转型升级。

10. 根据年报，公司正在加快转型升级，由传统 IBM 分销业务向云计算、大数据和系统集成等综合数据服务业务转型。请具体明确公司在云计算、大数据等新兴且为市场热点项目方面的具体转型进度，

已经进行的投资、配备的人员、形成的成果及未来的战略规划目标，以及公司在上述领域的盈利模式，并作相应的风险提示。

回复：

公司由传统 IBM 分销业务向云计算、大数据和系统集成等综合数据服务业务转型过程中，投入了大量的人力和资金开拓新的业务，在大数据工具平台软件、私有云技术集成、医疗大数据（肿瘤大数据医学分析平台、肿瘤疾病患者随访管理系统）等方面进行了技术开发和市场开拓，由于新业务开拓不力和 IBM 服务器分销业务市场需求大幅萎缩，广通科技持续亏损，公司于 2016 年 2 月 5 日将广通科技股权出售。但是，公司在编制 2015 年年度报告时尚未决定出售该公司股权，在年报中保留了向云计算、大数据和系统集成等综合数据服务业务转型的发展方向。

目前，广通科技原有的云计算、大数据业务公司已经停止，公司正积极推进清理低效无效资产，在集成电路和互联网综合数据服务领域积极寻找新的市场机会，通过内涵式发展和外延式并购，推动公司业务转型升级。

风险提示：公司正在互联网综合数据服务领域积极寻找新的发展机会，目前，并无实质性进展，敬请投资者注意投资风险。

11. 公司属于信息技术行业，研发对公司业务开展和转型升级，保持行业竞争力至关重要。报告期公司费用化的研发支出为 2045.92 万元，资本化的研发支出为 3601.54 万元，确认为无形资产的研发支

出为 863.23 万元。请公司：（1）结合自身业务分类，说明报告期内研发项目的目的、开始时点、进展、拟达到的目标及预计对公司未来发展的影响；（2）结合研发支出资本化及费用化的确认依据，说明报告期确认无形资产的金额与资本化金额差异较大的原因，请会计师发表意见。

回复：

公司 2015 年度研发投入金额合计为 5646.46 万元，其中：费用化金额为 2045.92 万元，资本化金额为 3601.54 万元，其中：由研发支出资本化转入无形资产核算金额 863.23 万元，公司外部采购研发用机器设备列入固定资产核算金额 2738.31 万元。

一、报告期内研发项目总体情况

公司在 2015 年度共投入大容量多功能 SIM 卡封装技术研发、金融双界面卡自动封装工艺技术研发等多项研发项目，研发的主要内容为提升公司应用于智能卡的重点关键技术，共计投入研发支出金额 5,646.46 万元。预计将在集成电路（IC）卡及模块封装业务领域形成较强的核心技术竞争力，增强公司在该领域市场竞争能力。

二、研发支出资本化及费用化的确认依据

公司按照《企业会计准则》关于研发支出的相关规定结合公司的实际情况对研发项目制定以下具体的确认原则：

公司研发模式主要分为三种类型，分别是自行开发、合作开发和外包开发。

自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系

统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台；合作开发是公司与合作专业 IT 公司（合作商）共同协作完成 IT 应用的项目实施和技术支持工作，一般形式是公司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT 系统的日常支持由技术研发部承担；外包开发是指将 IT 应用项目的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司（可以是专业的 IT 公司或咨询公司等），由该公司（承包商）负责应用项目的实施。公司对各种研发项目在研发阶段自主投入的支出进行费用化，在开发阶段自主投入的支出进行资本化。其中用于研发项目外部采购的机器设备满足固定资产确认标准的列入固定资产核算。

报告期内，公司金融双界面卡自动封装工艺技术研发、大容量 SIM 卡芯片减划技术研发等项目在研发阶段确认研发支出费用化支出 2,045.92 万元，明细如下：

单位：万元

项目	研发阶段	本期研发投入费用化金额
金融双界面卡自动封装工艺技术研发	研究阶段	366.00
大容量 SIM 卡芯片减划技术研发	研究阶段	620.00
WAFER 制备凸点工艺技术研发	研究阶段	396.00
SIM 小卡大规模测试及个人化生产技术	研究阶段	438.00
肿瘤大数据医学分析平台	研究阶段	107.04
肿瘤疾病患者随访管理系统	研究阶段	118.88
合 计		2,045.92

报告期内研发支出资本化金额 3,601.54 万元，其中：公司采购

研发用生产机器设备 2,738.31 万元（列入固定资产核算），研发支出中处于开发阶段并形成专利技术的项目转入无形资产金额为 863.23 万元（列入无形资产核算）。其中公司自主研发并进行资本化列入无形资产核算的项目明细如下：

项目	研发阶段	资本化时点	资本化依据	期末研发进度	专利证书申请日	专利申请号	专利号	授权公告日
肿瘤大数据医学分析平台	开发阶段	2015.4.1	鉴定意见书	完成	2015.4.2	2015SR161244	软著登字第 1048330 号	2015.5.5
					2015.3.10	2015SR161083	软著登字第 1048169 号	2015.3.20
肿瘤疾病患者随访管理系统	开发阶段	2015.10.10	鉴定意见书	完成	2015.10.14	2015SR235675	软著登字第 1122761 号	2015.10.21
					2015.10.20	2015SR235962	软著登字第 1123048 号	2015.10.25

会计师意见：

通过对公司研发支出的核查，公司在报告期内的研发支付费用化金额、资本化金额符合研发支出费用化及资本化确认原则。研发支出资本化确认为无形资产的金额与本期研发支出资本化金额差异主要为当期采购的研发用生产设备所致。

四、关于公司经营情况及经营计划

12. 请公司按照《格式准则第 2 号》第二十八条的要求，补充披露未来的业务发展规划、经营计划（包括收入、成本、费用计划）、下一年度的经营目标，如销售额的提升、市场份额的扩大、成本下降等，为达到上述经营目标拟采取的策略和行动及其他相关信息。

回复：

一、未来业务发展规划：集成电路（IC）卡及模块封装业务，公司将继续坚持科技创新和精益生产，巩固已有的领先优势，开拓国内外增量市场。充分发挥已有的竞争优势，抓住金融卡和电子证件大批量推广国产芯片、移动支付、物联网等新的市场机会，扩大具有领先优势的 CSP 生产技术和芯片减划产能，做大做强智能卡业务。

公司在集成电路（IC）卡及模块封装业务面临的挑战：新技术对传统智能卡市场的冲击，产业链整合导致竞争更加激烈。

为了加快转型升级，公司正积极推进清理低效无效资产，聚焦资源，并将利用公司多年积累的客户关系和人才资源，在集成电路和互联网综合数据服务领域寻找有利于公司发展的市场机会，通过内涵式发展和外延式并购，推动公司业务转型升级。

二、经营计划及目标

基于公司当前主营业务，2016 年计划营业收入 23,000 万元，营业成本 15,915 万元，期间费用 7,300 万元；2016 年，集成电路（IC）卡及模块封装销售额同比提升 10%，市场份额进一步提升；由于出售广通科技股权，2016 年中电广通合并报表销售额同比将会有所降低。

重点项目计划：开发《CSP 金融双界面耦合封装》技术，提升 8 寸、12 寸减薄划片产能提升。

风险提示：以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

三、拟采取的策略

稳步发展集成电路（IC）卡及模块封装业务，继续坚持科技创新和精益生产，巩固领先优势，开拓增量市场；继续清理低效无效资产和无利润销售业务，加快推进业务转型升级；控制成本，降低财务费用，加强风险管控，实现公司扭亏为盈；积极寻找有利于公司发展的市场机会。

13. 请公司按照《格式准则第 2 号》第二十七条的要求补充披露：

(1) 材料、人工、折旧、能源及制造费用等主营业务成本的构成情况；(2) 主要销售客户和主要供应商的情况，并披露前 5 大销售客户及供应商的金额及占比。

回复：

公司主营业务成本 323,628,257.65 元，其中：计算机系统集成与分销业务 175,913,459.07 元，主要为销售货物成本；集成电路（IC）卡及模块封装业务成本 147,714,798.58 元，其成本构成情况如下表：

单位：元

项目	主营业务成本金额	占主营业务总成本的比例 (%)
直接材料	93,100,895.38	63.03
直接人工	36,356,381.30	24.61
燃料动力	5,791,181.68	3.92
制造费用	12,466,340.22	8.44
合计	147,714,798.58	100.00

公司前五名销售客户金额合计为 161,140,339.76 元，占年度销售总额的比重为 39.38%；公司前五名供应商采购金额合计为 167,621,812.89 元，占年度采购总额的比重为 54.81%。

14. 在收入下滑的情况下,公司相关财务数据存在不配比的情况。请公司:(1)结合日常经营的结算方式,说明公司报告期末应付账款、应付票据及预收账款合计余额 2.43 亿元相比 2014 年上升 722 万元的原因;(2)说明公司管理费用中职工薪酬发生额 2172 万元相比 2014 年大幅上升 629 万元的原因。

回复:

一、报告期末应付账款、应付票据及预收账款变动情况如下表:

单位:元

科目名称	期末余额	期初余额	增长金额	增长比例%
应付账款	63,316,838.53	59,927,092.44	3,389,746.09	5.66
应付票据	139,000,180.99	138,208,955.83	791,225.16	0.57
预收款项	41,009,450.94	37,969,766.59	3,039,684.35	8.01
小计	243,326,470.46	236,105,814.86	7,220,655.60	3.06

1、应付账款期末较期初增加 338.97 万元,主要是子公司广通科技本期采购商品及应付账款未到付款期所致。

2、应付票据期末较期初增长 0.57%,属正常波动范围内。

3、预收账款期末较期初增加 303.97 万元,主要是公司加强销售合同管理,控制财务风险,增加预收账款比例。

二、公司管理费用中职工薪酬发生额较 2014 年上升 629 万元,主要原因是:2015 年确认了上年度绩效奖金,增加了部分生产线员工工资,缴纳社保基数上调。

五、关于资产剥离和集中计提减值准备

随着国内对信息安全的日益重视，信息系统去“IOE化”速度加快。公司从事 IBM 分销及集成业务的子公司也连续三年亏损，市场萎缩，收入由 2012 年的 11 亿下降为 2015 年的 1.9 亿。公司已于 2016 年 2 月出售上述业务，并在报告期大额计提减值准备。

15. 报告期公司对于上述业务相关的存货和应收账款分别计提了 9129 万元和 2518 万元的减值损失。请结合行业内其他 IBM 分销企业的资产减值计提情况，说明公司报告期大额计提减值的依据，以前年度对该连续亏损子公司是否按规定进行减值测试并计提相应减值准备，是否存在报告期集中大额计提资产减值的情况。请会计师发表意见。

回复：

一、存货计提跌价准备事项

1、政策背景

2014 年 2 月 27 日，中央网络安全和信息化领导小组成立，中国把信息化和网络信息安全列入了国家发展的最高战略方向之一。为了从根本上提升中国网络空间的防护能力，一个关键举措就是加快自主可控软硬件产品的研制，建立起完全自主、安全可控的 IT 系统，以上原因导致公司代销的 IBM 服务器滞销。

2、行业背景

2015 年以来，IBM 公司自身业绩大幅下滑，并大刀阔斧地缩减硬件业务，包括向联想售出 x86 服务器业务、倒贴 15 亿美元“甩卖”

芯片制造业务。由于业绩持续低迷，IBM 陆续裁员超过 10 万人。IBM 在中国国内大量裁减销售人员，国内各办事处已基本撤销。2016 年业务结构仍旧属于结构大调整，尚没有探底，但整体业绩逐步向从产品向新领域的服务转型。

3、同行业分析

(1) 作为 IBM 服务器在中国市场最大的分销商，神州数码控股有限公司(港交所：00861，以下简称：神州数码)于 2015 年 8 月 8 日发布公告：在过去三年间，系统及分销业务的收入和净利润逐渐下降，并影响集团公司的整体收入和盈利能力。董事会预期该部分业务未来的市场环境仍充满挑战。拟作价 40.1 亿元向深信泰丰出售 IT 产品分销业务，此次出售业务主要为传统的产品分销业务。

(2) 国内 2015 年 IBM 业务各分销商（产品提货数字）与 2014 年业绩比较：分销商 A 下降 15%，分销商 B 下降 12%，分销商 C 下降 25%，分销商 D 下降 30%，分销商 E 下降 35%。IBM 核心产品小型机，低端市场急剧萎缩，高端产品也在逐步下滑。

说明：由于其他分销商为非上市公司，公司名称以字母代替。

4、公司状况

公司 2015 年计提资产减值准备主要发生于控股子公司广通科技，该公司所处分销行业正经历 IBM 产品经营转型，随着国家大中型企业对信息安全认知度的提高，软硬件逐步被国产化产品所替代，受 IBM 销售萎缩影响，广通科技经营业务结构也已从单一 IBM 分销业务向信息服务、大数据等方向转变。截至报告期末，公司传统 IBM 分销

业务逐年萎缩，经营收入持续下滑，现有专属软硬件存货处于产品积压状态或者已无使用价值，部分呆滞存货出现了大幅减值的情形。

5、公司计提减值准备的依据

(1) 公司对期末存货进行全面清理并对技术落后产品、濒临淘汰等具有减值迹象存货进行市场价值分析。

(2) 借助专业评估机构对该批存货进行专项评估，评估结果如下表：

单位：万元

产品类型	账面成本	评估价值	评估减值金额
电子集成产品	14,225.53	6,316.48	7,909.05
电子软件产品	6,502.28	1,424.41	5,077.87
合计	20,727.81	7,740.89	12,986.92

(3) 根据公司清理结果并结合评估机构评估结果，公司对存在减值迹象存货计提减值准备 9,129 万元。

(4) 计提减值履行的审批程序

根据以上分析，公司计提存货减值准备 9,129 万元，并提交公司董事会审议通过。

6、以前年度计提减值准备情况

公司在以前年度，在各个报告期末均对存货价值进行减值测试，并根据减值测试结果计提存货跌价准备。以前年度计提减值准备如下：

单位：万元

项目	存货原值	当年计提存货跌价准备	计提依据
2014 年度	29,549.09	521.19	外部询价函、评估报告等
2013 年度	24,965.96	1,500.20	外部询价函、评估报告等

二、应收款项计提坏账准备事项

公司报告期末应收款项计提坏账准备主要体现在应收账款和其他应收款，各项坏账准备计提情况如下：

1、应收账款单项金额重大并单项计提坏账准备金额：

单位：元

债务人名称	核算科目	账面余额	坏账准备	计提理由
展桥伟业(北京)科技有限公司	应收账款	5,556,264.00	5,556,264.00	收回可能性低
广通信息(香港)有限公司	其他应收款	7,124,854.15	7,124,854.15	企业财务状况恶化 账款预计无法收回
合计		12,681,118.15	12,681,118.15	

(1) 应收款项形成情况

①展桥伟业应收账款形成原因：科技公司于2013年12月与展桥伟业签订销售合同，合同额5,556,264.00元，合同约定展桥伟业签收并验收无质量问题后分期在180日内支付全部款项。科技公司按照约定时间交货后，展桥伟业签收确认无质量问题并出具验收单，公司确认收入并形成应收账款5,556,264.00元。后因展桥伟业未及时销售所购买该批产品形成积压，现该批产品因技术更新换代成为市场淘汰产品，对方一直未销售出去，所以拖欠支付该笔款项，形成应收账款挂账。

②广通信息(香港)有限公司在2012年6月以前是广通科技(香港)有限公司的全资子公司，所欠款712.49万元为广通科技(香港)有限公司替广通信息(香港)有限公司缴纳的2005年至2008年期间的所得税储税卷。2012年6月广通科技(香港)有限公司将其持有的广通信息(香港)有限公司的100%股权全部转让给富崴有限公司

(WEALTH EXALT LIMITED)。转让后中电广通及所属子公司与广通信息（香港）有限公司不存在关联关系。

(2) 无法收回的原因说明

展桥伟业欠款因其所购买产品未能及时销售现在已经成为市场淘汰产品，该批货物已无使用价值，对方一直未销售出去，同时因行业状况恶化，展桥伟业财务状况也极具恶化，支付能力下降。针对该事项公司也曾多次索要货款，但对方一直拖欠不予支付。

鉴于香港思捷会计师行有限公司对广通科技（香港）有限公司审计报告中对该应收款项的损失确认，故 2015 年度参照香港事务所审计报告，依据谨慎性原则对此项应收全额计提了减值准备。

(3) 单项金额不重大并单项计提坏账准备金额

公司期末应收款项中大连新中连软件工程有限公司、华泰贝通网络科技有限公司、山西炎黄智杰科技有限公司等 22 个客户涉及应收账款共计 1,544.29 万元。

该部分款项大部分客户系电子产品行业下游企业，因行业状况变化，大部分客户因公司规模较小或者业务转型不及时造成财务状况恶化，基本不具备偿还能力，公司已经多次对该部分客户进行催收并对部分客户提起诉讼，法院也已判定公司胜诉，但对方拒不执行，考虑到该部分客户的财务状况及可收回性，依据谨慎性原则对这些应收账款全额计提了减值准备。

会计师意见：

通过对公司行业状况、市场状况、公司产品结构等分析，公司期

末存货因行业变革，技术革新、产品迭代原因，根据市场价格重估并参考评估机构评估结果并履行公司决策程序对期末存货充分计提了跌价准备。公司在以前年度期末均会对期末存货进行减值测试并根据当期期末市场价格情况充分计提了存货跌价准备，不存在报告期集中大额计提资产减值的情况。

报告期内应收款项计提坏账准备也均是因为行业状况变化，经营计算机系统集成与分销的下游企业也大面积出现财务困难，部分规模较小或者业务转型不及时的企业面临生存危机，该部分客户偿还状况的能力极度恶化，并出现法院判决无法执行的情形，综合以上原因，公司对该部分应收款项充分计提了减值准备。

16. 报告期公司分别对展桥伟业(北京)科技有限公司和广通信息(香港)有限公司的应收款项 555.63 万元和 712.49 万元全额计提了减值准备。请说明公司对无法回收的款项是否采取相关的追缴或诉讼措施，以及公司与广通信息(香港)有限公司之间是否存在关联关系。

回复：

一、展桥伟业应收款形成原因及无法收回原因如“问题 15 回复”。公司也曾多次索要货款，对方因市场更新换代无法销售要求退货。鉴于汽车配件市场更新换代因素及原合同条款瑕疵，即使通过诉讼也无胜算的可能，故全额计提减值准备。

二、广通信息（香港）有限公司在 2012 年 6 月以前是广通科技（香港）有限公司的全资子公司，现已无关联关系。所欠款 712.49

万元为广通科技（香港）有限公司替广通信息（香港）有限公司缴纳的 2005 年至 2008 年期间的所得税储税卷，经我公司与税务局多次交涉后仍无法收回。鉴于香港思捷会计师事务所有限公司对广通科技（香港）有限公司审计中对该应收款项的损失确认，故 2015 年度参照香港事务所审计报告，依据谨慎性原则对此项应收全额计提了减值准备。

六、其他

17. 信息技术行业资质、许可证照对公司开展业务至关重要。报告期公司 IBM 服务器分销资格已被取消，集成资质由二级降为三级。请公司说明上述信息是否属于影响公司生产经营的重大应披露信息，是否存在以年报代替临时公告的行为。

回复：

中电广通控股子公司广通科技主营业务包括 IBM 服务器硬件分销、IBM 软件分销、IBM 系统集成，IBM 分销商资格是基于年度销售任务完成情况。2013 年以来，一方面由于市场环境变化，另一方面由于公司主动控制风险，服务器分销业务销售规模持续缩减。

2015 年 11 月，广通科技收到 IBM 口头通知，服务器硬件分销资格将被取消，鉴于该业务占公司营业收入比重逐年降低，并发生亏损，公司计划压缩该业务，2015 年 9-11 月 IBM 服务器硬件分销业务销售收入 1,075 万元，所以，公司认为该业务不会对生产经营产生重大影响；集成资质降低会导致目标客户群范围缩小，也不会对公司生产经营产生重大影响，因此不属于影响公司生产经营的重大应披露信息。

特此公告。

中电广通股份有限公司

2016年3月15日